



(0,50mm) .01969"
BTH, BSH 系列

基础端子条和插座条

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?BTH 或 www.samtec.com?BSH

绝缘体材料: 液晶聚合物
 触点材料: 磷铜
 电镀: 在 50µ" (1,27µm) 的镍上镀金或锡
 额定电流: 1.25A @ 80°C 环境
 可燃性等级: UL 94 VO
 工作温度范围: -55°C 至 +125°C
 额定电压: 125 VAC
 最大循环数: 100
 符合 RoHS 规范要求: 是

加工: 无铅可软焊性: 是
 SMT 引线共面度: 最大 (0,10mm) .004" (030-090) 最大 (0,15mm) .006" (120-150)
 电路板相叠: 对于每板或不少于 90 个位置需要超过两个连接器的应用, 请发邮件至 ipg@samtec.com



BTH — **每排位置数** — **01** — **电镀选项** — **D** — **A** — **其他选项**

配接: BSH

-030, -050, -060, -090, -120, -150

-F = 触点闪镀金, 尾端镀雾锡
-L = 10µ" (0,25µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡
-C* = 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81µm) 镍底上至少 50µ" (1,27µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27µm) 的镍底上镀雾锡

-K = (7,00mm) 0.276" 直径聚酰亚胺薄膜取放垫
-TR = 卷带封装 (最多 120 个位置)



堆叠高度

引线式样	堆叠高度*
-01	(5,00) .197

*加工条件将影响配接高度。

BSH — **每排位置数** — **01** — **电镀选项** — **D** — **A** — **其他选项**

配接: BTH

-030, -050, -060, -090, -120, -150

-F = 触点闪镀金, 尾端镀雾锡
-L = 10µ" (0,25µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡
-C* = 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81µm) 的镍底上至少 50µ" (1,27µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27µm) 的镍底上镀雾锡

-TR = 卷带封装 (最多 120 个位置)

特殊应用选项

- 30µ" (0,76µm) 镀金
- 边缘封装能力
- 8mm、11mm、16mm、19mm 和 22mm 堆叠高度 (注意: 有些自动置放/检验设备可能对组件高度有限制。请参考设备规范。)(11mm、16mm、19mm 和 22mm 不适用于 50 个位置)。

请致电 Samtec。

AGILENT 逻辑分析器测试点连接器
 指定: ASP-65067-01

*注: -C 电镀已通过十年 MFG 测试
 注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。